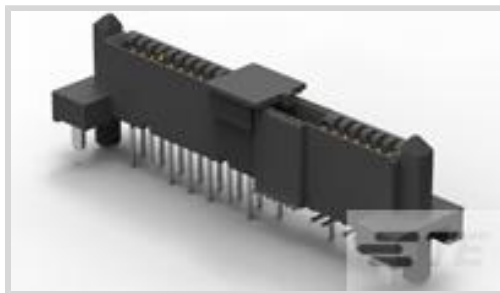




连接器 > PCB 连接器 > SAS 和 MiniSAS > PT30 XFP 连接器



SAS 连接器类型: SAS

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 板对板

位数: 29

行数: 1

[所有 PT30 XFP 连接器 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

外壳	不带
连接器和端子端接到	印刷电路板
SAS 连接器类型	SAS
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	板对板

结构特性

键控类型	SAS
位数	29
行数	1
端口数量	1
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金

端子额定电流 (最大值)	1.5 A
--------------	-------

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.31 mm[.17 in]
PCB 端接方法	表面贴装, 通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊钉
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]

尺寸

PCB 的外形高度	9.85 mm[.387 in]
-----------	------------------

使用环境

高温壳体	是
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	高速数据
------	------

行业标准

PCIe/SAS 世代	Gen2
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	140
封装方法	卷带包装, 卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

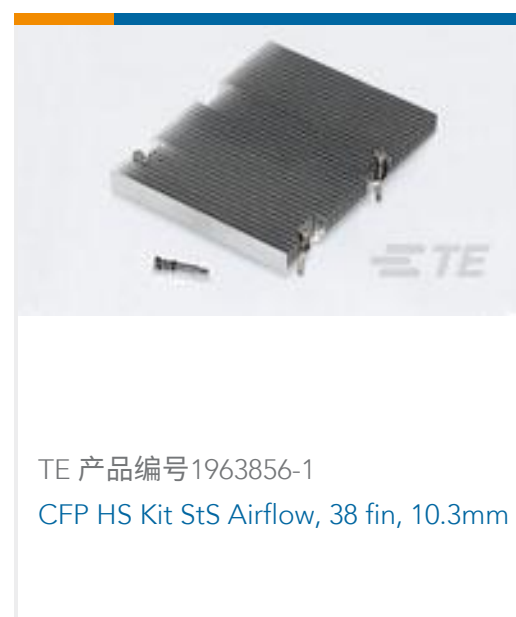
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

产品图纸

SAS BACKPLANE RECEPT, VERTICAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1735104-6_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1735104-6_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1735104-6_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本